

苏州锴威特半导体股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称“锴威特”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕1512号文同意注册。《苏州锴威特半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址 www.cs.com.cn；上海证券报网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司的住所，供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网站上的《苏州锴威特半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》。

发行人基本情况			
公司全称	苏州锴威特半导体股份有限公司	证券简称	锴威特
证券代码/网下申购代码	688693	网上申购代码	787693
网下申购简称	锴威特	网上申购简称	锴威申购
所属行业简称	计算机、通信和其他电子设备制造业	所属行业代码	C39
本次发行基本情况			
发行方式	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行		

定价方式	网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。		
发行前总股本 (万股)	5,526.3158	拟发行数量(万股)	1,842.1053
预计新股发行 数量(万股)	1,842.1053	预计老股转让数量 (万股)	-
发行后总股本 (万股)	7,368.4211	拟发行数量占发行 后总股本的比例 (%)	25.0000
网上初始发行 数量(万股)	525.0000	网下初始发行数量 (万股)	1,225.0001
网下每笔拟申 购数量上限 (万股)	600.0000	网下每笔拟申购数 量下限(万股)	100.0000
初始战略配售 数量(万股)	92.1052	初始战略配售占拟 发行数量比(%)	5.0000
保荐人相关子 公司初始跟投 股数(万股)	92.1052	高管核心员工专项 资管计划认购股数 /金额上限(万股/ 万元)	不适用
是否有其他战 略配售安排	否		
本次发行重要日期			
初步询价日及 起止时间	2023年8月3日(T-3日) 9:30-15:00	发行公告刊登日	2023年8月7日(T-1日)
网下申购日及 起止时间	2023年8月8日(T日) 9:30-15:00	网上申购日及起止 时间	2023年8月8日(T日) 9:30-11:30, 13:00-15:00
网下缴款日及 截止时间	2023年8月10日(T+2 日) 16:00	网上缴款日及截止 时间	2023年8月10日(T+2日) 日终
发行人和保荐人(主承销商)			
发行人	苏州锴威特半导体股份有限公司		
联系人	严泓	联系电话	0512-58979950
保荐人(主承 销商)	华泰联合证券有限责任公司		
联系人	薛峰	联系电话	021-38966911

发行人：苏州锴威特半导体股份有限公司

保荐人(主承销商)：华泰联合证券有限责任公司

2023年7月31日

本页无正文，为《苏州锴威特半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）

苏州锴威特半导体股份有限公司



本页无正文，为《苏州锴威特半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）

